

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MeiG Smart Technology Co., Ltd.

美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3268)

須予披露交易 關於投資AI研發及先進製造產業項目並簽署投資協議

緒言

作為全球無線通訊模組及解決方案提供商，本公司致力於建設研發驅動型伽丸 > 迺翫驚作為投資方，將於南通市北高新技術開發區轄區內投資製造產業項目，其中包括高算力AI模組、ASIC服務器、高智能、5G+AIoT模組等方向的研發中心及SIP封裝等先也建設，該項目總投資人民幣3億元。

投資協議之主要條款

日期 2026年4月15日

訂約方

1. 本公司；及
2. 南通市北高新技術開發區

項目

根據投資協議，本公司作為投資方，將於南通市北高新技術開發區轄區內投資建設AI研發及先進製造產業項目，南通市北高新技術開發區須協助本集團於其轄區內的投資行為、協調項目建設用地及適用的相關扶持政策。

如本公司取得下述項目建設用地，本公司將進行研發中心及先進工藝製造廠房建設，具體包括：研發辦公樓、實驗室、先進製造生產車間及配套設施等。上述設施建成後，本公司擬購置先進的SMT貼片線等自動化生產設備，建立本公司自己的生產製造能力。AI研發及先進製造產業項目建設及生產設備購置等具體資金投入，本公司將於投資協議簽訂生效日後到2030年期間，根據項目進度及實際需求逐步進行。

此外：

1. 根據投資協議，及基於本公司綜合考慮項目用地、研發中心和先進工藝製造車間的建設費用、研發及生產設備的購置費用及後續研發投入等，該項目總投資為人民幣3億元。其中，該總投資包括(i)固定資產投資(因本公司擬建造車載SIP封裝工藝產線，對設備的先進性有較高要求，設備投資不低於人民幣1.5億元)、(ii)預留現金流(佔總投資約20%)及(iii)項目用地投資；及

2. 本公司需在南通市北高新技術開發區轄區內新註冊公司(本公司全資持有)或遷入其他本公司全資附屬公司

扶持政策及其可能補貼	根據投資協議，南通市北高新技術開發區將協助本公司申請有關政府扶持政策之補貼，包括設備補貼、人才綜合補貼及人才購房補貼、科創補貼、國家級補貼及課稅補貼。截至本公告日，上述補貼及金額暫未落實，亦視乎有關政策及其更新。
違約責任	1. 南通市北高新技術開發區未按投資協議約定時間、標準向本公司交付項目用地，或未按期完成水、電、氣、路、通訊等配套保障的，致使項目無法實施的，本公司有權單方解除投資協議。 2. 南通市北高新技術開發區干預項目正常建設、運營管理，或無正當理由單方解除、終止協議、收回項目經營權，本公司有權單方解除投資協議。 3. 本公司未按投資協議約定時間、金額履行相關投資的，南通市北高新技術開發區有權取消相關扶持政策。 4. 本公司擅自改變項目用地性質、建設內容、投資主體或產業方向的，南通市北高新技術開發區有權責令限期整改；拒不整改的，南通市北高新技術開發區有權單方解除投資協議。

有關訂約方的資料

本公司

本公告載有涉及風險及不明確因素的前瞻性陳述。除過往事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述，舉例而言，包括但不限於包含「預計」、「預計的」、「相信」、「估計」、「預期」、「預期的」、「打算」、「目標」、「可能」、「也許」、「規劃」、「預測」、「計劃」、「尋求」、「指標」、「潛在」、「將」、「會」、「可以」、「可」、「應該」、「繼續」等詞語的陳述以及類似表述。該等陳述涉及已知及未知的風險、不明確及其他因素，當中部分並非本公司所能控制，且可導致實際業績、表現或成果與該等前瞻性陳述所明示或暗示者存在重大差異。閣下不應依賴前瞻性陳述作為未來事件的預測。本公司預計，後續事件及發展可能導致其觀點發生變化。雖然本公司可能選擇在未來某個時間更新該等前瞻性陳述，但本公司明確聲明，除非法律要求，否則本公司並無義務更新該等陳述。

釋義

在本公告中，除非文意另有所指，下列詞語或詞組具有如下含義：

「AI」	指	人工智能
「AI研發及先進製造產業項目」	指	AI研發及先進製造產業項目，其中包括高算力AI模組、ASIC服務器、高算力車載SIP模組、具身智能、5G+AIoT模組等方向的研發中心及SIP封裝等先進工藝的中試、製造基地建設
「A股」	指	本公司每股面值為人民幣1.00元的普通股，於深圳證券交易所上市並以人民幣買賣
「ASIC」	指	定制芯片
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣

「本公司」	指	美格智能技術股份有限公司，一家於2015年5月14日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：3268)，A股於深圳證券交易所上市(證券代碼：002881)
「董事」	指	本公司董事
「設備投資」	指	包括生產設備、研發設備、辦公設備、測試設備，實驗設備，倉儲運輸設備、消防工程及設備、環保工程及設備、裝修工程等固定資產投資
「懋集團指憶憶		

「研發」	指	研究及開發
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「SIP」	指	系統封裝
「%」	指	百分比

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
 董事長
王平

中國·深圳
 2026年4月15日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。